

（正高）级专业技术资格申报人基本情况及评审登记表

姓名	王维昀	性别	男	出生	1974年1月	参加工作时间	1996年7月	现工作单位	松山湖材料实验室					现任行政职务	高级工程师	
何时毕业于何院校何专业	2007年毕业于华南理工大学/材料工程		本专业最高学历	本科	学位	工程硕士	办学形式	全日制	现资格专业及名称	电子工程高级工程师	现资格获得方式	评审	现资格获得时间	2008.11	现资格发证单位	广东省人事厅
现从事何专业技术工作	半导体器件专业	现受聘何专业技术职务	半导体器件高级工程师	从事本专业或相近专业技术工作			24年	申报何专业技术资格	(轻工电器)专业(正高级工程师)资格			有无同时或不同时申报其他系列(专业)资格及其名称			无	
职称外语考试							全国计算机应用能力考试					专业实践能力考试(考评结合专业填写)				
已获得A级别合格证	成绩81分,属倾斜范围		考试时间	2008.4		属	免试范围		已获得5个模块合格证	属		政策倾斜范围		考试专业	考试成绩	考试时间
主要工作经历	2010年6月至2014年4月,任东莞市福地电子材料有限公司副总经理。 2014年4月至2015年4月,任山东晶泰星光电科技有限公司总工程师。 2015年5月至2018年9月,任东莞市鑫詮光电技术有限公司总工程师。 2019年1月至今,任松山湖材料实验室高级工程师。															
专业技术工作经历(能力)及业绩成果情况	<p>本人自评认为具备专业技术工作经历(能力)条件第<u>（一）（二）</u>项、业绩成果条件第<u>（三）（七）</u>项之规定,主要理由(注明时间、项目内容(含效果、评价、获奖情况等)及个人完成量、所起作用或排名):</p> <p>(1) 2015年4月-2018年3月,以第一完成人主持开发广东省重大科技专项“标准光组件检测与品质保障关键技术研究及产业化”项目,并通过专家验收。项目总投资1097万元,其中省财政资金300万元。该项目设计并生产了标准化的LED光组件接口,通过广东省光组件码认证,开发了专用的测试夹具和测试系统,取得了较好的经济和社会效益。</p> <p>(2) 2009年2月至2011年2月,以第三完成人负责2009年度粤港关键领域重点突破项目(东莞专项)---LED大功率芯片制造技术研究及产业化。该项目经专家委员会鉴定,在LED芯片制造技术方面达到了国内领先水平,产生了良好的社会和经济效益,并荣获了2012年东莞市科技进步一等奖。</p> <p>(3) 2011年5月至2013年7月,以第一完成人主持2011年省产学研项目“超高亮度功率型AlGaInP 四元系LED 芯片结构设计及制备”,并通过专家验收,该项目实现年销售收入1842万元,利税217万元。</p> <p>(4) 2019.8至今,作为主要责任人(第二完成人),负责广东省2019年重点领域研发计划项目“新型功率器件无机封装陶瓷基板”。</p> <p>获副高资格以来,先后获授权发明专利6件:《一种结构改良的LED芯片》(排名第一)、《一种LED芯片的制备方法》(排名第一)、《LED倒装芯片》(排名第一)、《一种芯片倒装的发光二极管及其制造方法》(排名第一)、《一种LED高压电源》(排名第一)、《氮化镓基大功率芯片侧面的高阶侧腐蚀方法》(排名第四)。先后获授权实用新型专利10件(其中8件排名第一,2件排名第二)。</p> <p>本人在科技创新工作实践中,结合科技项目和专利发明的创新思想,作为第一作者先后在中国核心期刊半导体技术发表《激光钻孔GaN基LED可靠性研究》、中国核心期刊固体电子学研究与发展发表《激光钻孔技术对氮化镓LED特性的影响》等2篇论文,作为第二作者参与发表2篇论文。</p> <p>本人于2012年荣获东莞市科技进步一等奖(第三完成人)。</p>															
本人对负面工作的说明: 无。																
提交论文、著作或	标题内容	作者名次	何时发表何刊物杂志				刊号	获奖情况(何部门批准及奖励名称、等级)								
提交论文、著作或	激光钻孔 GaN 基 LED 可靠性研究	第一	2011年10月/半导体技术				ISSN 1003-353X	无								
	激光钻孔技术对氮化镓 LED 特性的影响	第一	2011年12月/固体电子学研究与发展				ISSN 1000-3819	无								
	红光 LED 尺寸对 ITO 电流扩展的影响	第二	2012年12月/半导体技术				ISSN 1003-353X	无								
	化学镀金在 GaN 基发光二极管电极制备上的应用	第二	2013年3月/光学与光电技术				ISSN 1672-3392	无								
评前公示	_____年 月 日(公章)															
本人承诺: 以上所填写及提交的材料内容真实,并对此负责和承担相应后果。 申报人签名: _____年 月 日																
以上填写的内容,已经我单位核对无误,并对此负责和承担相应后果。 单位负责人签名: _____年 月 日																
单位负责人签名: _____年 月 日																
专业学科组评审情况	学科组人数	到会人数	同意票	不同意票	评委会评审结果					评委会人数	到会人数	同意票	不同意票			

说明: 1、此表由申报人填写后用 A3 纸单面打印,经单位审核盖章(高级一式 20 份、中级一式 15 份、初级一式 10 份,其中 1 份原件;评委会另有要求的按其要求提交)送相应评委会日常工作部门。2、“现资格取得方式”指评审、考核认定、考试。3、单位审核评价意见字数不少于 150 字。4、此表供评委会评审时了解申报人基本情况之用,评审结束后评委会日常工作部门应将本表原件填上评审结果,并按专业技术资格审批、发证表名单顺序装订上报资格核准机关备查。

()评委会公章:

_____年 月 日